

輕量化發泡材料與技術研討會

高分子發泡材料是以氣體物質為分散相，固體樹脂為分散介質所組成的分散體，它是一類帶有許多氣孔的塑料製品。由於高分子發泡材料具有質輕、導熱係數低、吸濕性小、彈性好、比强度高、緩衝能力、隔音絕熱等優點，可應用於電子、光電、化粧品、食品等各種產品包裝，並讓讓材料輕量化或賦予功能。

本次研討會特於 6/6 (一) 邀請國內外學者專家，針對輕量化微發泡材料射出成型技術、超臨界發泡材料發展、輕量化微孔成型技術研究，以及高分子發泡產品市場發展趨勢等議題進行交流討論。期待大家共襄盛舉，更希望藉由本次活動，加深對發泡材料技術與市場應用的了解，以利業者投入高值化發泡材料研發。

議程



Time	Topic	Speaker
8:30-9:00	Registration	
9:00-9:20	Opening remark	Dr. Jen-Lien Lin, Deputy General Director, MCL/ITRI 林正良 博士 工研院材化所副所長 主持人： Dr. Yih-Her Chang Director, Division of Polymer Research, MCL/ITRI 張義和 博士 工研院高分子組組長
9:20-10:20	國際高分子發泡產品技術實務 與未來發展趨勢	Dr. S.T. Lee Sealed Air Corporation 李紹唐 博士 / 希悅爾公司
10:20~10:50	Tea Break	
10:50-11:50	超臨界流體微細發泡成型技術 發展趨勢與應用	Prof. Shia-Chung Chen Chung Yuan Christian University 陳夏宗 教授 / 中原大學
11:50-13:00	Lunch	
13:00-14:00	微孔注塑成型在工藝、材料 和應用的最近發展	Prof. Lih-Sheng Turg University of Wisconsin 童立生 教授 / 威斯康辛大學
14:10-14:30	Tea Break	
14:30-15:30	聚酯發泡技術發展	Mr.Chang Lin Far East University 林煒章 主任 / 遠東科技大學
15:30-16:10	超臨界流體二氧化碳 押出發泡技術進展	Prof. Shu-Kai Yeh National Taiwan University of Science and Technology 葉樹開 教授 / 國立台灣科技大學
16:10-16:40	輕量化發泡材料技術發展簡介	Division of Polymer Research, MCL/ITRI 梁文忠 資深研究員 / 工研院高分子組
16:40~17:00	Discussion & Summary	

- ◎活動日期：105 年 6 月 6 日 (一) 8：30-17：00
- ◎活動地點：工研院 17 館國際會議廳 (新竹市光復路二段 321 號)
- ◎活動費用：此活動由經濟部工業局部份費用補助，特享優惠價**\$1,000**元/人(含講義、精緻午餐、餐點及稅)
註：發票皆開立上課當月公司抬頭發票 (此場活動不適用折價券，其他需求請於報名時註名並告知)
- ◎注意事項：①名額有限，請提早報名，額滿為止。上課當天，現場不受理臨時報名！
②報名截止日：**5/30**，凡報名者於活動三天前 Mail 或傳真【出席通知單】。
③若遇不可抗力之因素，塑膠中心保留更換講者及內容之權利。
④活動前五天取消者，得全額退費。
活動前五天內取消者，則酌收學費之 10%手續費。
活動前一天及開課當天取消者，恕不退費。
⑤若遇不可抗力之因素，主辦單位保留活動日期、講師、內容更換之權利。
- ◎聯絡窗口：若對本課程有疑問請洽詢 04-23595900 分機 406 詹小姐,E-mail：yun2016@pidc.org.tw。

-----◆報名表回傳◆-----

(傳真後請來電，以確認完成報名，FAX：04-23507998)

6/6 輕量化發泡材料與技術研討會 (105050606)					
公司全名	<input type="checkbox"/> 有限公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司			公司統編	
營業項目				公司員工 人數	
聯絡地址	□□□□□			傳真號碼	
人資人員		e-Mail		聯絡電話	分機
參加者姓名	身分證字號	學歷	部門/職稱	e-Mail	
聯絡電話	分機		手機號碼 (上課通知用)		
	分機				
	分機				
繳費方式	※恕不接受現場繳費，請先行繳費以完成報名手續※ <input type="checkbox"/> 郵政劃撥 - 戶名：財團法人塑膠工業技術發展中心 帳號：21531154 <input type="checkbox"/> 即期支票 - 抬頭：財團法人塑膠工業技術發展中心 郵寄至 40768 台中市工業區 38 路 193 號-知識發展部收 <input type="checkbox"/> ATM/匯款 - 中國信託商業銀行台中分行 (銀行代號：822·帳號：026540017045) 匯款日期：__月__日 匯款帳號後五碼：□□□□□				劃撥 / 匯款
發票種類	<input type="checkbox"/> 二聯式(個人) <input type="checkbox"/> 三聯式(公司) ★若未特別註明，一律開立 <input type="checkbox"/> 繳費當月發票 <input type="checkbox"/> 上課當月發票 三聯式、上課當月發票				收據黏貼處
備註					